2018-2023年中国半导体行业市场现状规模分析与投资前景规划预测报告

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国半导体行业市场现状规模分析与投资前景规划预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/297820297820.html

报告价格：电子版: 7200元　纸介版：7200元　电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联 系 人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体行业高景气，国内行业高速发展

全球半导体产业景气度持续提升，根据统计，全球硅晶圆连续六季度出货保持增长，2017Q2 出货面积 2978 百万平方英寸，环比增长 4.2%，同比增长 10.1%，创历史新高。半导体行业是一个国家的战略支柱产业。

硅晶圆出货量是全球半导体产业的先行指标，出货量创新高一方面是全球芯片代工厂和 IDM 厂商积极备货的原因，特别是中国芯片制造产能扩张带动的需求，另一方面反应了消费电子、汽车电子、通讯、物联网等下游产业对芯片的强劲需求。

图：16Q1~17Q2 全球硅晶圆出货（百万平方英寸）

图：2017~2020 不同区域新建 Fab 统计

根据中国半导体行业协会统计，2017 年 1~6 月中国集成电路产业销售额为 2201.3 亿元，同比增长 19.1%。其中，设计业同比增长 21.1%，销售额为 830.1 亿元；制造业同比增速达到25.6%，销售额为 571.2 亿元；封装测试业销售额 800.1 亿元，同比增长 13.2%。

图：1999 年至 2016 年中国集成电路设计行业产值及同比增速（单位：亿元）

半导体制造升温，大陆地区晶圆代工厂投资建设加速，全球晶圆产能向大陆地区转移。国内共有 12 座在建 12 寸晶圆厂，并有 10 座拟建设 12 寸晶圆厂，投资进度加快。

根据统计，2017 年中国总计有 14 座晶圆厂正在兴建，并将于 2018 年开始装机。总计2017 年中国将有 48 座晶圆厂有设备投资，支出金额达 67 亿美元。到 2018 年中国晶圆设备支出总金额将逾 100 亿美元，增长将超过 55%，全年支出金额位居全球第二。

表：国内在建 12 寸晶圆厂信息

表：国内拟建设 12 寸晶圆厂信息

半导体材料体系逐渐完善，国产化进程开始加速。根据统计，中国目前已和日本并列成为第三大半导体材料市场，全球市场占比为 15%。中国半导体材料行业实现了从半导体制造到半导体封装领域的覆盖，主要产品包括硅片、光刻材料、溅射靶材、CMP 抛光液、电子化学品等，应用领域包括集成电路、功率器件、太阳能等领域，部分产品进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子等国内主流半导体制造厂商。

图：2016 年按地区分类全球 Fab 产能

图：2016 年按地区分类全球半导体材料市场

存储器产业开始发展，下游需求旺盛。NOR Flash 需求快速上涨，来源于 AMOLED

面板出货大幅增长、TDDI 渗透率提升以及物联网需求增加。据 WitsView 的数据，2017 年AMOLED出货量大幅增长和 TDDI 渗透率提升，将新增约 1.54 亿个 NOR Flash 需求。中国存储器市场取得重大突破，武汉新芯进度符合预期，闪存芯片迎来新一轮高景气。

图：2017 年全球 NOR Flash 月产能市场占有率

MCU、MEMS 市场高速发展，物联网带动半导体未来增长。物联网快速发展、汽车电子的渗透率提升、工业 4.0 对自动化设备的旺盛需求带动 MCU 快速发展。根据 IC Insights 统计，全球 MCU 出货量将从 2015 年的约 221 亿个增长至 2020 年的约 267 亿个，市场容量将从 2015年的 159 亿美元增长至 2020 年 209 亿美元，MCU 平均单价将从 2015 年的 0.72 美元提升至2020 年的 0.78 美元。

图：2013~2020 年 MCU 市场发展状况预测

MEMS 细分领域众多，下一个增长点是物联网。国内 MEMS 产业链完整，蓄势待发。中国是全球 MEMS 传感器最大的市场，重点产品包括运动类、声学类、射频类、红外成像等领域，构建了从科研、产品开发、设计到代工制造、封装测试、下游应用的完整产业链。物联网将是半导体的下一个增长极。根据 Gartner 2015 年发布的研究，2020 年物联网发展驱动的全球半导体市场规模将达到 435 亿美元，其中数据处理相关的芯片规模最大，约为 248 亿美元，传感器相关的芯片规模约为 100 亿美元，联网相关的芯片规模约为 86 亿美元。

图：2020 年物联网半导体市场规模（单位：十亿美元）资料来源：中国报告网整理

中国报告网发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章 2015-2017年中国半导体材料产业运行环境分析

第一节 2015-2017年中国宏观经济环境分析
一、中国GDP分析
二、城乡居民家庭人均可支配收入
三、恩格尔系数
四、中国城镇化率
五、存贷款利率变化
六、财政收支状况
第二节 2015-2017年中国半导体材料产业政策环境分析
一、《电子信息产业调整和振兴规划》
二、新政策对半导体材料业有积极作用
三、进出口政策分析
第三节 2015-2017年中国半导体材料产业社会环境分析

第二章 2015-2017年半导体材料发展基本概述
第一节 主要半导体材料概况
一、半导体材料简述
二、半导体材料的种类
三、半导体材料的制备
第二节 其他半导体材料的概况
一、非晶半导体材料概况
二、GaN材料的特性与应用
三、可印式氧化物半导体材料技术发展

第三章 2015-2017年世界半导体材料产业运行形势综述
第一节 2015-2017年全球总体市场发展分析
一、全球半导体产业发生巨变
二、世界半导体产业进入整合期
三、亚太地区的半导体出货量受金融危机影响较小
五、模拟IC遭受重挫，无线下滑幅度最小
第二节 2015-2017年主要国家或地区半导体材料行业发展新动态分析
一、比利时半导体材料行业分析
二、德国半导体材料行业分析
三、日本半导体材料行业分析
四、韩国半导体材料行业分析
五、中国台湾半导体材料行业分析

第四章 2015-2017年中国半导体材料行业运行动态分析
第一节 2015-2017年中国半导体材料行业发展概述
一、全球代工将形成两强的新格局
二、应加强与中国本地制造商合作
三、电子材料业对半导体材料行业的影响
第二节 2015-2017年半导体材料行业企业动态
一、元器件企业增势强劲
二、应用材料企业进军封装
第三节 2015-2017年中国半导体材料发展存在问题分析

第五章 2015-2017年中国半导体材料行业技术分析
第一节 2015-2017年半导体材料行业技术现状分析
一、硅太阳能技术占主导
二、产业呼唤政策扩大内需
第二节 2015-2017年半导体材料行业技术动态分析
一、功率半导体技术动态
二、闪光驱动器技术动态
三、封装技术动态
四、太阳光电系统技术动态
第三节 2018-2023年半导体材料行业技术前景分析

第六章 2015-2017年中国半导体材料氮化镓产业运行分析
第一节 2015-2017年中国第三代半导体材料相关介绍
一、第三代半导体材料的发展历程
二、当前半导体材料的研究热点和趋势
三、宽禁带半导体材料
第二节 2015-2017年中国氮化镓的发展概况
一、氮化镓半导体材料市场的发展状况
二、氮化镓照亮半导体照明产业
三、GaN蓝光产业的重要影响
第三节 2015-2017年中国氮化镓的研发和应用状况
一、中科院研制成功氮化镓基激光器
二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
三、非极性氮化镓材料的研究有进展

四、氮化镓的应用范围

第七章 2015-2017年中国其他半导体材料运行局势分析
第一节 砷化镓
一、砷化镓单晶材料国际发展概况
二、砷化镓的特性
三、砷化镓研究状况
四、宽禁带氮化镓材料
第二节 碳化硅
一、半导体硅材料介绍
二、多晶硅
三、单晶硅和外延片
四、高温碳化硅

第八章 2015-2017年中国半导体分立器件制造业主要指标监测分析
第一节年中国半导体分立器件制造行业数据监测回顾
一、竞争企业数量
二、亏损面情况
三、市场销售额增长
四、利润总额增长
五、投资资产增长性
六、行业从业人数调查分析
第二节2015-2017年（按季度更新）中国半导体分立器件制造行业投资价值测算
一、销售利润率
二、销售毛利率
三、资产利润率
四、未来5年半导体分立器件制造盈利能力预测
第三节2015-2017年（按季度更新）中国半导体分立器件制造行业产销率调查
一、工业总产值
二、工业销售产值
三、产销率调查

第九章 2015-2017年中国半导体市场运行态势分析
第一节 LED产业发展
一、国外LED产业发展情况分析

二、国内LED产业发展情况分析
三、LED产业所面临的问题分析
四、2018-2023年LDE产业发展趋势及前景分析
第二节 集成电路
一、中国集成电路销售情况分析
二、集成电路及微电子组件进出口数据分析
三、集成电路产量统计分析
第三节 电子元器件
一、电子元器件的发展特点分析
二、电子元件产量分析
三、电子元器件的趋势分析
第四节 半导体分立器件
一、半导体分立器件市场发展特点分析
二、半导体分立器件产量分析
三、半导体分立器件发展趋势分析

第十章 2015-2017年中国半导体材料行业市场竞争态势分析
第一节 2015-2017年欧洲半导体材料行业竞争分析
第二节 2015-2017年我国半导体材料市场竞争分析
一、半导体照明应用市场突破分析
二、单芯片市场竞争分析
三、太阳能光伏市场竞争分析
第三节 2015-2017年我国半导体材料企业竞争分析
一、国内硅材料企业竞争分析
二、政企联动竞争分析

第十一章中国半导体材料主要生产商竞争性财务数据分析
第一节 有研半导体材料股份有限公司
（1）企业概况
（2）主营业务情况分析
（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析
第二节 天津中环半导体股份有限公司
（1）企业概况
（2）主营业务情况分析

（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析
第三节 宁波康强电子股份有限公司
（1）企业概况
（2）主营业务情况分析
（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析
第四节 南京华东电子信息科技股份有限公司
（1）企业概况
（2）主营业务情况分析
（3）公司运营情况分析
（4）公司优劣势分析

第十二章 2018-2023年中国半导体材料行业发展趋势分析
第一节 2018-2023年中国半导体材料行业市场趋势
一、2018-2023年国产设备市场分析
二、市场低迷创新机遇分析
三、半导体材料产业整合
第二节 2018-2023年中国半导体行业市场发展预测分析
一、全球光通信市场发展预测分析
二、化合物半导体衬底市场发展预测分析
第三节 2018-2023年中国半导体市场销售额预测分析
第四节 2018-2023年中国半导体产业预测分析
一、半导体电子设备产业发展预测分析
二、GPS芯片产量预测分析
三、高性能半导体模拟器件的发展预测

第十三章 2018-2023年中国半导体材料行业投资咨询分析
第一节 2018-2023年中国半导体材料行业投资环境分析
第二节 2018-2023年中国半导体材料行业投资机会分析
一、半导体材料投资潜力分析
二、半导体材料投资吸引力分析
第三节 2018-2023年中国半导体材料行业投资风险分析
一、市场竞争风险分析
二、政策风险分析

三、技术风险分析
第四节 专家建议
图表目录:
图表 1中国主要宏观经济数据增长表
图表 2 2015-2017年中国GDP及其增长率统计表
图表 3 2015-2017年中国GDP增长率季度统计表
图表 4 2015-2017年中国GDP增长率季度走势图
图表 52015-2017年中国居民收入及恩格尔系数统计表
图表 6 中国城乡居民收入走势对比
图表 7 2015-2017中国城乡居民恩格尔系数对比表
图表 8 2015-2017中国城乡居民恩格尔系数走势图

更多图表详见正文（GSLWK）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/297820297820.html